POT/JF00/08741

11.12.00

日本国特許

EJU

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JP00/874

RECT. 0 5 FEB 2881

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年12月10日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第351805号

住友電気工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



2001年 1月19日









出証番号 出証特2000-3113240

【書類名】

特許願

【整理番号】

099Y0403

【提出日】

平成11年12月10日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01S 3/025

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社 横浜製作所内

【氏名】

吉村 学

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業

株式会社 大阪製作所内

【氏名】

吉田 和宣

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業

株式会社 大阪製作所内

【氏名】

古米 正樹

【特許出願人】

【識別番号】

000002130

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

[識別番号]

100088155

【弁理士】

【氏名又は名称】 長谷川 芳樹

【選任した代理人】

【識別番号】

100089978

【弁理士】

塩田 辰也 【氏名又は名称】

【選任した代理人】

【識別番号】 100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

【選任した代理人】

【識別番号】 100108257

【弁理士】

【氏名又は名称】 近藤 伊知良

【選任した代理人】

【識別番号】 100110582

【弁理士】

【氏名又は名称】 柴田 昌聰

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9908938

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 光半導体モジュール

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の軸に交差する基準面に沿って延びる搭載部材と、

前記所定の軸に沿って伸びる管状部、前記管状部の一端に設けられ前記搭載部材に固定された第1の端部、および前記管状部の他端に設けられた第2の端部を有する第1の部材と、

光軸が前記所定の軸に沿うように前記第1の部材の前記管状部内に配置された 光半導体素子と、

前記所定の軸に沿って伸びる管状部を有し前記第1の部材の前記第2の端部に 固定された第2の部材と、

前記光半導体素子と光学的に結合し、前記第2の部材の前記管状部において伸びる光導波路と、

を備える光半導体モジュール。

【請求項2】 前記第2の部材の前記管状部に収納されたフェルールを更に 備え、

前記光導波路は、前記フェルールに支持された光ファイバを含む、請求項1に 記載の光半導体モジュール。

【請求項3】 前記所定の軸に沿って伸び前記第2の部材および前記フェルールを収容している管状部並びに前記管状部の両端に設けられた一対の開口部を有する第3の部材を更に備え、

前記光ファイバは、前記第2の部材の前記一対の開口部の一方を通過して前記 フェルールに到達する、請求項とに記載の光半導体モジュール。

【請求項4】 前記フェルールは第1の端面および第2の端面を有し、

前記光ファイバは、前記フェルールの前記第1の端面から前記第2の端面に伸びる、請求項2に記載の光半導体モジュール。

【請求項5】 前記フェルールが挿入されているスリーブを更に備え、

前記第2の部材は、前記管状部の内壁面に設けられた凹部を有し、

前記スリーブは、前記第2の部材の前記凹部に配置されている、請求項2また

は請求項4に記載の光半導体モジュール。

【請求項6】 前記第2の部材の前記管状部は、前記所定の軸に沿って隣接している第1および第2の部分を有し、前記第1の部分は前記フェルールを収容し、前記第2の部分は前記光ファイバと光学的に結合されるべき別の光ファイバを保持している別のフェルールを挿入可能なように設けられている、請求項2、請求項4および請求項5のいずれかに記載の光半導体モジュール。

【請求項7】 前記光導波路と前記光半導体素子との間に設けられたレンズを更に備える請求項1~請求項6のいずれかに記載の光半導体モジュール。

【請求項8】 前記光半導体素子は発光素子および受光素子のいずれかである、請求項1~請求項7のいずれかに記載の光半導体モジュール。

【請求項9】 前記第1の部材は、前記光半導体素子の光軸に重なる直線を 囲むように設けられた環状の接続部において前記搭載部材に固定されている、請 求項1~請求項8のいずれかに記載の光半導体モジュール。

【請求項10】 前記搭載部材は、前記基準面に直交する軸を中心とする直径4mm以下の断面の円筒形内に含まれている、請求項1~請求項9のいずれかに記載の光半導体モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光半導体モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】

従来の光半導体モシュール100は、TO型CANカース102と、カース102に収納された発光素子104と、発光素子104に光学的に結合する光ファイバ106と、光ファイバ106を支持するフェルール108と、フェルール108を支持する支持部材110と、を備える。支持部材110は、CANケース102の側面に接着部材112を用いて固定され発光素子104の光軸に沿って伸びる筒状を有し、これによって、光ファイバ106と発光素子104とを光学的に結合することを可能にしている。



【発明が解決しようとする課題】

発明者は、このような光半導体モジュールを小型化するための検討を行っている。この検討の結果、発明者は、この技術分野では特に光半導体モジュールの光軸に直交する面における形状を縮小することに対する要求があることを見出した

[0004]

そこで、本発明の目的は、このような小型化が可能な構造を備える光半導体モジュールを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】

これを実現するために、発明者はさらに検討を重ねた。

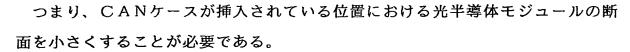
[0006]

まず、従来の光半導体モジュールが有するそれぞれの部品の役割について検討を行った。TO型CANケースは、半導体レーザといった光半導体素子または半導体受光素子を収納している。支持部材は、このような半導体発光素子または半導体受光素子に光ファイバを光学的に結合させるために設けられている。支持部材は、光ファイバを保持しているフェルールの挿入方向を規定する挿入孔を有する。フェルールの向きは、支持部材の挿入孔内にCANケースを差し込む角度によって決定されている。このため、支持部材の筒状部は、CANケースの外径に合わせて決定された内径を有している。この構造は、CANケースと支持部材との位置合わせによって、光ファイバを発光素子の光軸に一致させることを可能にしている。

[0007]

次いで、このような役割を発揮している部品を備える光半導体モジュールにおいて、光軸に直交している面の形状を調査した。すると、CANケースに挿入される支持部材の部分における断面が、光半導体モジュールの他の部分に比べて縮小が困難であることを発見した。

[0008]



[0009]

これを実現するための構造を検討した結果、以下の本発明をするに至った。

[0010]

本発明に係わる光半導体モジュールは、搭載部材と、第1の部材と、光半導体素子と、第2の部材と、光導波路と、を備える。搭載部材は、所定の軸に交差する基準面に沿って伸びる。第1の部材は、所定の軸に沿って伸びる管状部、この管状部の一端に設けられ搭載部材に固定された第1の端部、および管状部の他端に設けられた第2の端部を有する。光半導体素子は、光軸が所定の軸に沿うように第1の部材の管状部内に配置されている。第2の部材は、所定の軸に沿って伸びる管状部を有し第1の部材の第2の端部に固定されている。光導波路は、光半導体素子と光学的に結合可能なように第2の部材の管状部において伸びている。

[0011]

第1の部材を搭載部材に固定しているので、搭載部材および第1の部材が、光 半導体素子を収容する空間を規定している。第2の部材は、光導波路が伸びる方 向を規定している。第2の部材が第1の部材の第2の端部に固定されている。こ の固定によって、光導波路と光半導体素子との光学的な結合を可能にする方向が 規定される。

[0012]

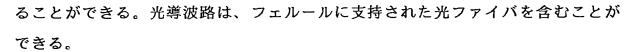
搭載部材および第1の部材が光半導体素子の収容空間を規定しているので、従 東で光半導体ラジェールできまた。 支持部材がCENA・プの外側に配置される 形態を有する必要がない。 したがって、小型化が可能な構造を有する。

[0013]

本発明は、以下に記述される1又は複数の特徴を任意に組み合わせることが可能である。

[0014]

本発明に係わる光半導体モジュールは、フェルールを更に備えることができる。フェルールは、第2の部材の管状部に収納されることができ、さらに固定され



[0015]

光ファイバを支持したフェルールは第2の部材の管状部に収納されるので、管 状部によってガイドされる。これによって、光ファイバと光半導体素子との光学 的な結合が可能になる。また、フェルールは第2の部材に固定されているので、 安定な光学的結合が実現される。

[0016]

本発明に係わる光半導体モジュールは、管状部および一対の開口部を第3の部材を更に備えることができる。第3の部材の管状部は、所定の軸に沿って伸び第2の部材およびフェルールを収容している。一対の開口部は、管状部の両端に設けられている。光ファイバは、一対の開口部に一方を通過してフェルールに到達している。

[0017]

第2の部材およびフェルールは、第3の部材の管状部に収容され、これによって保護される。光ファイバが一対の開口部の一方を通過するので、第3の部材は、フェルールに到達するまでの光ファイバを進む方向をガイドし、光ファイバの屈曲可能な範囲を制限している。これによって、フェルールへの挿入位置において光ファイバに予期しない力が加わることを抑制している。

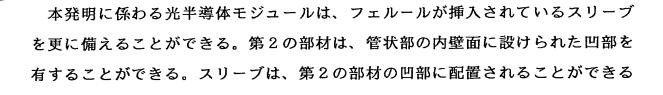
[0018]

本発明に係わる光半導体モジュールでは、フェルールは第1の端面および第2 の端面を有することができる。また、光ファイバは、フェルールの第1の端面から第2の端面に伸びることができる。

[0019]

光ファイバの端部は、第1および第2の端面の両方に現れている。このため、 第1および第2の端面の一方において、光半導体素子と光学的に結合されること ができる。また、第1および第2の端面の他方において、別の光ファイバと光学 的に結合することができる。

[0020]



[0021]

スリーブは、第2の部材の所定位置に設けられた凹部に収容され、これよって 、フェルールの配置位置を規定することができる。

[0022]

本発明に係わる光半導体モジュールでは、第2の部材の管状部は、所定の軸に沿って隣接している第1および第2の部分を有することができる。第1の部分はフェルールを収容している。第2の部分は、光ファイバと光学的に結合されるべき別の光ファイバを保持している別のフェルールを挿入可能なように設けられている。光半導体素子が、別の光ファイバとの光学的が達成されることができる。また、管状部の内壁面は、挿入される別の光ファイバをガイドし、スリーブは、光学的な軸合わせを可能にする。

[0023]

本発明に係わる光半導体モジュールは、光導波路と光半導体素子との間に設けられたレンズを更に備えることができる。これによって、光半導体素子と光導波路との間の光学的な結合を強めることが可能にされる。

本発明に係わる光半導体モジュールでは、光半導体素子は発光素子および受光素子のいずれかできることができる。発光素子の場合には、光ファイバに光信号を提供することができる。受光素子の場合には、光ファイバからの光信号を受け電気信号に変換することができる。

[0025]

本発明に係わる光半導体モジュールでは、第1の部材は、光半導体素子の光軸に重なる直線を囲むように設けられた環状の接続部において搭載部材に固定されている。環状の接続部は高い対称性を有するので、固定の際において、第1の部材の変位が均一化されることができる、

本発明に係わる光半導体モジュールでは、搭載部材は、基準面に直交する軸を中心とする直径4mm以下の断面の円筒形内に含まれていることができる。本明細書において既に説明されたまたはこれから説明される光半導体モジュールの構造を備えると、直径4mm以下の円筒形内に収まる程度の大きさが実現可能になる。

[0026]

【発明の実施の形態】

本発明の知見は、添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮することによって容易に理解することができる。以下、図面と共に本発明による光半導体モジュールの好適な実施形態について詳細に説明する。図面の説明においては、同一要素には同一符号を付して重複する説明を省略する。図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。

[0027]

(第1の実施の形態)

図1および図2を参照しながら、本発明の実施の形態に係る光半導体モジュール10を説明する。光半導体モジュール10は、搭載部材20と、光半導体素子22と、第1の部材30と、第2の部材34と、光導波路40と、を備える。また、光半導体モジュール10は、光半導体素子22と光導波路40との間に設けられたレンズ32といった集光手段を更に備えることができる。光半導体モジュール10は、スリーブ36およびフェルール38を備えることができ、スリーブ36にはフェルール38が挿入されている。スリーブ36およびフェルール38に、第2の部材54に収納されることができ、光導波路40は、フェルール38に支持された光ファイバを含むことができる。

[0028]

光半導体モジュール10においては、搭載部材20、光半導体素子22、第1の部材30、レンズ32、第2の部材34、スリーブ36、フェルール38、および光導波路40が、所定の方向に伸びる軸12に沿って配置される。この軸は、光半導体素子22に関連する光軸に一致するように選択することができる。以下の説明は、光導波路として光ファイバを適用した場合について行われる。実施

の形態においては、光ファイバは、コア部およびこの周囲に設けられたクラッド部を有する光導波路である。光ファイバ素線とは、周囲が樹脂によって被覆された光導波路を意味し、このような光ファイバ素線の直径は250μm程度である。光ファイバ素線のフェルールに挿入される部分では、樹脂被覆が剥離されている。

[0029]

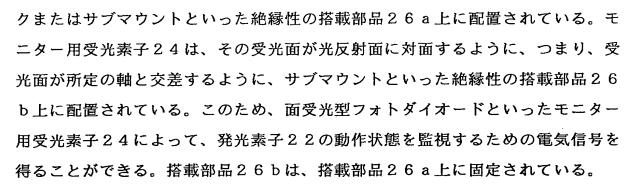
搭載部材20は、所定の軸12に交差する基準面に沿って伸びる板状の部材であり、例えば鉄製の部材に金メッキを施した金属製部材である。搭載部材20は、基準面に沿って伸びる部品搭載面20aおよび端子配置面20bを有する。部品搭載面20aには、所定の軸12に沿って伸びる支持突起部20cが設けられている。支持突起部20cは、光半導体素子22を搭載するための支持面20dを有し、支持面20dは所定の軸12に沿って伸びている。支持面20d上には、受光素子および発光素子といった光半導体素子22が配置されている。

[0030]

図1は、半導体レーザ素子といった光半導体素子22を採用した光半導体モジュール10を例示的にしてしているけれども、発光ダイオードといった光半導体素子22を適用することもできる。波長1.3μm帯半導体レーザ素子には、InGaAsP/InPから構成される多重量子井戸構造のファブリペロー型レーザダイオードやDFB型レーザダイオードを適用することができる。波長1.55μm帯半導体レーザ素子には、InGaAsP/InPから構成される多重量子井戸構造のファブリペロー型レーザダイオードやDFB型レーザダイオードを適用することができる。また、光軸を含わせるように配置すれば、発光素子に代えて、面受光型フォトダイオードといった受光素子を適用することもできる。この場合には、受光面が所定の軸12に、例えば直角といった所定の角度で、交差している。

[0031]

光半導体素子22として半導体レーザを採用した図1の例示に従って説明すれば、半導体レーザ素子22は、光共振器を構成するように光放出面および光反射面を有し、光放出面および光反射面が所定の軸12と交差するようにヒートシン



[0032]

端子配置面20bには、1または複数の端子電極28、本実施例では、4本の端子電極28が設けられている。端子電極28は、所定の軸12に沿って伸び、部品搭載面20aから端子配置面20bに貫通する孔に挿入されている。端子電極28は、端子配置面20bから突出する外部端子部と、部品搭載面20aから突出する内部端子部とからなる。発光素子22および受光素子24は、ボンディングワイヤといった接続部材28を介して内部端子部に電気的に接続されている。端子電極28は、絶縁部材28aを介して搭載部材20に固定されることができる。これによって、端子電極28は、また、絶縁部材28aを介することなく搭載部材20に固定されることができる。これによって、端子電極28は、また、絶縁部材28aを介することなく搭載部材20に固定されることができる。これによって、端子電極28と搭載部材20との電気的な接続が達成される。故に、本実施の形態に係わる光半導体モジュール10の動作の際に、搭載部材20および第2の部材30等を接地することができる。

[0033]

第1の部材30は、所定の軸12に沿って伸びている管状部30a、管状部30aの一端に設けられた第1の端部30ト、および管状部30aの他端に設けられた第2の端部30cを有する。第1の部材30は、ステンレスといった金属製部材であることができる。第1の端部30bは、搭載部材に接触する固定面30dを備えている。固定面30dには、軸12を囲むように連続している環状突起30eが設けられている。第1の部材30は、固定面30dが搭載部材20の接触面20eと対面するように固定されている。この固定は、例えば以下のように行うことができる。環状突起30eを接触面20eに接触させるように、搭載部材20上に第1の部材30を配置する。搭載部材20と第1の部材30との間に

所定値を超える電流を流す。この電流は環状突起30eに集中するので、ジュール熱が、主にこの部分において発生し温度が上昇する。この温度が融点を超えると環状突起30eが溶融するので、搭載部材20は、第1の部材30と溶接によって固定されることになる。この固定によれば、連続した溶接部分は形成されるので、この接合部分の気密性が確保されると共に、搭載部材20は、第1の部材30と電気的に接続される。搭載部材20および第1の部材30は、また、絶縁部材28aを介すことなく搭載部材20に電気的に接続された端子電極28を介して接地されることができる。

[0034]

管状部30aは、所定の軸12に沿って伸びる内壁面30fを有する。内壁面30fは、レンズ32を支持するように設けられた環状の突出部30hを備え、突出部30hは、軸12を囲むように設けられた保持面30gによって規定されるレンズ配置孔30iを形成する。レンズ32は、レンズ配置孔30iに収容され、紫外線硬化樹脂および熱硬化樹脂といった接着部材42を介して第1の部材30に固定される。接着部材42が、レンズ32と保持面30gとの間を接着するように環状に形成されると、この部位における気密性を確保することができる。第2の端部30cは、第2の部材34を支持するための端面30jを有する。レンズ配置孔30iによって、レンズ32の位置決めが可能になる。固定されたレンズ30は、光半導体素子22の光放出面に対面している。

[0035]- --

第1の部材30が搭載部材20上に固定されると、部品搭載面20a、内壁面 たでまたおよび穿無部とのまじます。当当選位基子25が収容された空間が規 定される。このため、第1の部材30は、ハウジングまたは収容部材の役割を有 している。環状突起30eおよび接着部材42によって、収容空間の気密性が確 保されるばかりでなく、TO型CANケースを用いることないので小型化が可能 な構造が提供される。

[0036]

第2の部材34は、所定の軸12に沿って伸びる管状部34aを有する。第2 の部材34は、ステンレスといった金属製部材であることができる。管状部34 aの一端部34bには、スリーブ36およびフェルール38を挿入する開口が設けられている。このため、一端部34bには、テーパ面34dが設けられている。他端部34cには、光半導体素子22からの光が通過する開口が設けられている。

[0037]

第2の部材34は、第1の部材30の第2の端面30jに対面するように配置される固定面34eを有する。光の受け入れを確実に行うように、第2の部材34は第1の部材30に対して位置合わせされる。第2の部材34は、固定面34eの外周において第1の部材30に固定されている。この固定は、複数の固定部48a、48b(図2参照)において達成される。また、固定は、例えばYAGレーザ光を用いて、複数の位置において同時に行われる。このようなレーザ溶接といった固定部を対称性高く配置すると、固定によって生じる可能性のある歪みを低減することができる。これによって、光ファイバ40と光半導体素子22との光学的な結合の低下を低減できる。

[0038]

第2の部材34は、軸12に沿って伸びる内壁面34fを有する。内壁面34fは、スリーブ36およびフェルール38を収納するために空間と、これらをガイドする方向とを規定している。内壁面34fは、スリーブ36を収納するための凹部34gを有する。凹部34gは、軸12の周囲を囲むように閉ループ状に伸びる。凹部34gは、スリーブ36を収納することが可能な長さおよび深さを有する溝であることができる。

[0039]

第2の部材34が筒状の部材であるので、凹部34g内には割スリーブまたは精密スリーブといったスリーブ36が配置されることが好ましい。割スリーブというスリーブ36は、所定の軸に沿って伸びる円柱殻の形状を有する筒状部36aと、所定の軸に沿って伸び筒状部36aに設けられた間隙36bとを有している。このため、間隙36bの間隔を縮小するようにして、第2の部材34の内壁凹部34gに挿入することができる。挿入された割スリーブでは間隙36bの縮小が開放されるので、スリーブ36の外面が凹部34gの壁面に接触し、これに

よって、スリーブ36の位置が固定される。

[0040]

第2の部材34は、外壁面34hに外壁凹部34iを有する。この凹部34i は、第2の端子34cにフランジ部を形成する。外壁凹部34iは、固定面34 eに沿って伸びる面34mを有することができる。外壁凹部34iの複数の位置 にYAGレーザを照射すると、第2の部材34と第1の部材30とを複数の固定 部48a、48b(図2参照)において溶接することができる。外壁凹部34iを 設けると、第2の部材34と第1の部材30と位置合わせを行った後にこれらの 部材30、34の固定を固定面34eで行うことが容易になる。この形態を採用 すると、複数の固定部48a、48bを同時に形成することができる。

[0041]

フェルール38は、スリーブ36内に収納され、スリーブ36の締め付け力によって第2の部材30内における位置が決定される。また、スリーブ36へのフェルール38の固定は、例えば溶接によって行われることもできる。第2の部材30に対してフェルール38の位置が固定されるので、光ファイバ40の一端40aとレンズ32との光学的な結合が安定化される。また、フェルール38の配置位置は、レンズ32の焦点距離によって変更されることができる。

[0042]

フェルール38は、第1の端面38a、第2の端面38b、および第1の端面38aから第2の端面38bに軸12に沿って伸びる孔38c、を有する。孔38cには、樹脂が剥がされた光ファイバ40が挿入されている。好ましくは、第1の端面38aには、光ファイバ40を引きといじ挿入した後に研磨されることができる。この研磨によって、それぞれの端面38a、38bに光ファイバ40の端部が確実に現れる。

[0043]

第1の端面38bは、光半導体モジュール10の軸12に対して第1の角度、 例えば略直角になるように研磨されていることができる。この端面38bを採用 すると、半導体光モジュール10に光学的に結合されるべき光ファイバ(図1に おいては、別個のフェルール44に挿入されている光ファイバ46)と光学的な 結合が容易になる。例示的に、詳述すれば、フェルール44の一端部44aは、 テーパを形成するように研磨されている。この研磨により光ファイバ46はレン ズ化端部を有するようになる。レンズ化端部46aが、フェルール38の端面3 8aに物理的な接触をすることが可能になる。

[0044]

第2の端面38 cは、光半導体モジュール10に軸12に、角度0°を越える第1の角度 α 、例えば6°程度に傾斜されていることができる。この傾斜された端面38 cを採用すると、フェルール38の第2の端面38 cにおける反射光が光半導体素子22に戻ることが抑制される。

[0045]

図2を参照すると、第2の部材34の管状部34aは、軸12に沿って隣接している第1および第2の部分34j、34kを有する。第1の部分34jはフェルール38を収容している。第2の部分34kは、光ファイバ40と光学的に結合されるべき別の光ファイバ(図1の40)を保持している別のフェルール(図1の44)を挿入可能なように設けられている。

[0046]

以上詳細に説明したように、搭載部材20は、所定の平面に直交する軸12を中心とする直径L≦4mmの断面の円筒形内に含まれるように形成することができる。また、搭載部材20、第1の部材および第2の部材34は、所定の平面に直交する軸12を中心とする直径L≦4mmの断面の円筒形内に含まれるように形成することができる。つまり、小型化可能な構造を有する光半導体モジュールが提供された。

10047)

(第2の実施の形態)

図3および図4は、別の実施の形態に係わる光半導体モジュール14を示している。

[0048]

図3および図4を参照しながら、別の実施の形態に係る光半導体モジュール1 4を説明する。光半導体モジュール14は、搭載部材20と、光半導体素子22 と、第1の部材60と、第2の部材64と、光導波路70と、を備える。また、 光半導体モジュール14は、光半導体素子22と光導波路70との間に設けられ たレンズ62といった集光手段を更に備えることができる。フェルール68は、 第2の部材64に収納されることができ、光導波路70は、フェルール68に支 持された光ファイバを含むことができ、光導波路70の一端は光半導体素子22 と光学的に結合し、光導波路70の他端は光コネクタプラグ74に到達している る。さらに、光半導体モジュール14では、フェルール68には光ファイバ70 が挿入されている。

[0049]

光半導体モジュール14においては、所定の方向に伸びる軸16に沿って、搭載部材20、光半導体素子22、第1の部材60、レンズ62、第2の部材64、ガイド部材66、フェルール68、光導波路70および光コネクタプラグ74が配置される。図3および図4において、搭載部材20は、図1および図2に示された形態と同じであるけれども、これに限定されることはなく、別の形態の採用することもできる。

[0050]

第1の部材60は、所定の軸16に沿って伸びている管状部60a、管状部60aの一端に設けられた第1の端部60b、および管状部60aの他端に設けられた第2の端部60cを有する。第1の部材60は、ステンレスといった金属製部材であることができる。第1の端部60bは、搭載部材20に接触する固定面60dを備えている。固定面60dには、軸16を囲むように連続している環状空戸FCにが設けられている。少二の部材FCに 固定面FC が推載部材20の接触面20eと対面するように固定されている。この固定には、これに限定されるものではないが、第1の実施の形態と同様の方法を採用することができ、同様の作用および効果が得られる。

[0051]

管状部60aは、所定の軸16に沿って伸びる内壁面60fを有する。内壁面60fは、レンズ62を支持するように設けられた環状の突出部60hを備え、 突出部60hは、レンズ62を支持するように設けられた支持面60gを備える 。レンズ62は、管状部60aに収容され、突出部60hによって位置決めされた状態で、第1の実施の形態と同様に、接着部材78(図4)を介して第1の部材60に固定される。このため、光半導体素子22の光放出面がレンズ62と対面している。

[0052]

接着部材78(図4)が、レンズ62と内壁面60fとの間を接着するように環状に形成されると、この部位における気密性を確保することができる。突出部60hの位置は、レンズ62の焦点距離、およびレンズと光半導体素子20との距離を考慮して決定されるべきである。

[0053]

第2の端部60cは、第2の部材64を支持するための端面60jを有する。

[0054]

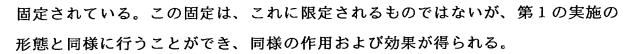
第1の実施の形態と同様に、第1の部材60が搭載部材20上に固定されると、部品搭載面20a、内壁面60f、および突起部60gによって、光半導体素子22が収容される空間が規定される。このため、第1の部材60は、ハウジングまたは収容部材の役割を有している。環状突起60eおよび接着部材78によって、収容空間の気密性が確保される。これによって、TO型CANケースを用いることないので小型化が可能な構造が提供される。

[0055]

第2の部材64は、所定の軸16に沿って伸びる管状部64aを有する。第2の部材64は、ステンレスといったスリーブであることができる。管状部64a の一端部64bには、フェルール38を挿入する開口が設けられている。他端部64cには、光半導体素子22からの光が通過する開口が設けられている。また、他端部64cには、フランジ部が設けられている。

[0056]

第2の部材64は、第1の部材60の第2の端面60jに対面するように配置 される固定面64eを有する。第2の部材64に挿入されるフェルール68との 位置合わせを確実に行うために、第2の部材64は第1の部材60に対して位置 合わせされている。第2の部材64は、固定面64eにおいて第1の部材60に



[0057]

第2の部材64は、軸16に沿って伸びる内壁面64fを有する。このため、 内壁面64fは、フェルール68を収納するために空間を規定している。このために、内壁面64fは、フェルール68の外周に接触し、フェルール68を挿入する方向を規定している。また、フェルール68は、第2の部材64に固定されている。このため、フェルール68に挿入されている光ファイバ70と、光半導体素子22との光学的な結合が可能になる。

[0058]

フェルール68は、第1の端面68a、第2の端面68b、および第1の端面68aから第2の端面68bに軸16に沿って伸びる孔68cを有する。孔68cには、樹脂が剥がされた光ファイバ70が挿入されている。好ましくは、第2の端面68bは、光ファイバ70を孔68cに挿入した後に研磨されることができる。この研磨によって、第2の端面68bに光ファイバ70の端部70aが確実に現れる。

[0059]

第2の端面68cは、光半導体モジュール14の軸16に対して0°を越える第1の角度βだけ傾斜されていることができる。この値は、第1の実施の形態と同じ程度の値を採用することができ且つ同様の作用および効果を得ることができるけれども、この値に限定されるものではない。

[0060]

フェルール68の貴通孔68cを通過した光ファイバ10は、保護部材12といった第3の部材の収容部72aを通過している。保護部材72は収容部72a を備える。収容部72aは、所定の軸16に沿って伸び第1および第2の開口を 有する筒状の空間である。このために、第1の開口72eからは、光ファイバ7 0が挿入された状態の第2の部材64およびフェルール68を挿入することが可能であり、また、第2の開口72fには光ファイバ70が通過することが可能である。



図4を参照すると、保護部材72の収容部72aは、隣接して設けられた第1の部分72b、第2の部分72c、および第3の部分72dを有する。第1の部分72bには、第2の部材64およびフェルール68が収容される。第2の部分72cには、光ファイバ70が通過する。第3の部分72dには、光ファイバ70が指示される。第2の部分72cでの光ファイバ70は、保護部材72およびフェルール68の間での光ファイバ70のずれを吸収することができる。

[0062]

保護部材72は、難燃性ゴムといった弾性材料で形成されている。このため、 保護部材72は、フェルール68を収容できると共に、光ファイバ70に加わる 曲げ力を吸収することができ、これによって、光ファイが70を保護している。

[0063]

図3を参照すると、光ファイバ70の他端部には、光コネクタ74が設けられている。光コネクタ74は、ハウジング80と、ハウジングに固定されたフェルール76とを備える。ハウジング80は、所定の軸16に沿うようにフェルール76を保持している。フェルール76の一端には、光ファイバ70に他端70bが現れている。

[0064]

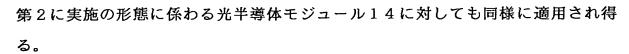
図4においては、光半導体素子22で発生された光の伝搬経路が示されている

[0065]

リ上詳細に説明したように、本実施の形態においても集」の実施の形態と同様に、搭載部材20、第1の部材60および第2の部材64は、直交する軸16を中心とする直径L≦4mmの断面の円筒形内に含まれるように形成することができる。つまり、小型化可能な構造を有する光半導体モジュールが提供された。

[0066]

図5(a)および図5(b)は、第1の実施の形態に示された光半導体モジュール 10を配線基板に固定するための固定部材90,94を示している。第1の実施 の形態に示された光半導体モジュール10を例示にしながら説明するけれども、



[0067]

図5(a)を参照すると、固定部材90は、環状のモジュール支持部90aおよび一対の設置部90bを備える。モジュール支持部90aは、光半導体モジュール10の搭載部材20の周囲および/またはその近傍を囲む接触面90dを有し、光半導体モジュール10を支持する。支持部90aは、切り欠き部90eを有する。切り欠き部90eを設けると、光半導体モジュール10を固定部材90に挿入することが容易になる。設置部90bは、配線基板(図示せず)に接触するように設けられ軸12方向に伸びる接触面90cを有する。また、設置部90bには、固定用の一対の孔92a、92bが設けられている。固定されるべき配線基板に固定部材90の接触面90cが対面するように光半導体モジュール10を配置する。この配置で、ボルトといった固定用部品を一対の孔92a、92bの各々に挿入し固定する。光半導体モジュール10は、配線基板が広がる方向に沿う軸12が伸びる配置で固定される。

[0068]

図5(b)を参照すると、固定部材94は、環状のモジュール支持部94aおよび一対の設置部94bを備える。モジュール支持部94aは、光半導体モジュール10の搭載部材20の周囲および/またはその近傍を囲む接触面94dを有し、光半導体モジュール10を支持する。設置部94bは、配線基板(図示せず)に接触するように設けられ、軸12、例えば直角に、に沿う接触面94cを有する。また、設置部94bには、固定用の一対の孔962、96bが設けられている。固定されるべき配線基板に固定部材94の接触面94cが対面するように光半導体モジュール10を配置する。この配置で、ボルトおよびナットといった固定用部品を一対の孔96a、96bの各々に挿入し固定する。光半導体モジュール10は、配線基板と交差、例えば直交する方向に軸12が伸びる配置で固定される。

[0069]

【発明の効果】

以上詳細に説明したように、本発明に係わる光半導体モジュールでは、管状の第1の部材が搭載部材に固定されているので、搭載部材および第1の部材が、光半導体素子を収容する空間を規定している。第2の部材は、光導波路が伸びる方向を規定している。第2の部材が第1の部材の第2の端部に固定されているので、この固定によって、光導波路と光半導体素子との光学的な結合を可能にする方向が規定される。また、第1の部材が光半導体素子の収容空間を規定しているので、従来の光半導体モジュールのように、支持部材がCANケースの外側に配置される形態を有する必要がない。したがって、小型化が可能な構造を備える光半導体モジュールが提供された。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、第1の実施の形態に係わる光半導体モジュールの斜視図である。 【図2】

図2は、第1の実施の形態に係わる光半導体モジュールの断面図である。 【図3】

図3は、第2の実施の形態に係わる光半導体モジュールの斜視図である。 【図4】

図4は、第2の実施の形態に係わる光半導体モジュールの断面図である。 【図5】

図 5_(-a-)_および_(b) は、固定部材と光半導体モジュールとの関係を示した 図面である。

[図6]

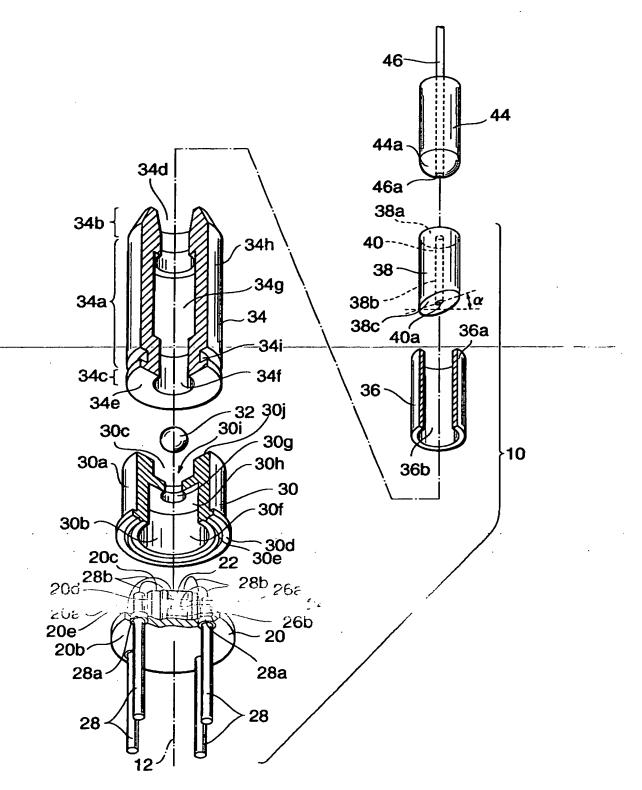
図もは、従来の光半導体モジュールの形態を示す図面である。

【符号の説明】

20…搭載部材、 22…発光素子、 24…受光素子、 30、60…第1の部材、 32、62…レンズ、 34、64…第1の部材、 36…スリーブ、 38、68…フェルール、 40、70…光導波路(例えば、光ファイバ)、 90、94…固定部材、

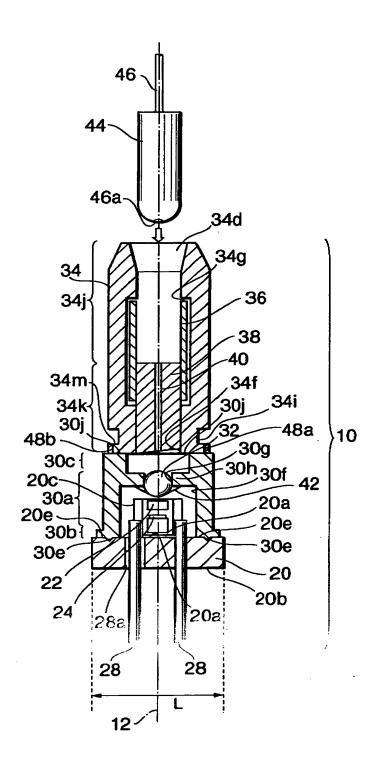


【図1】

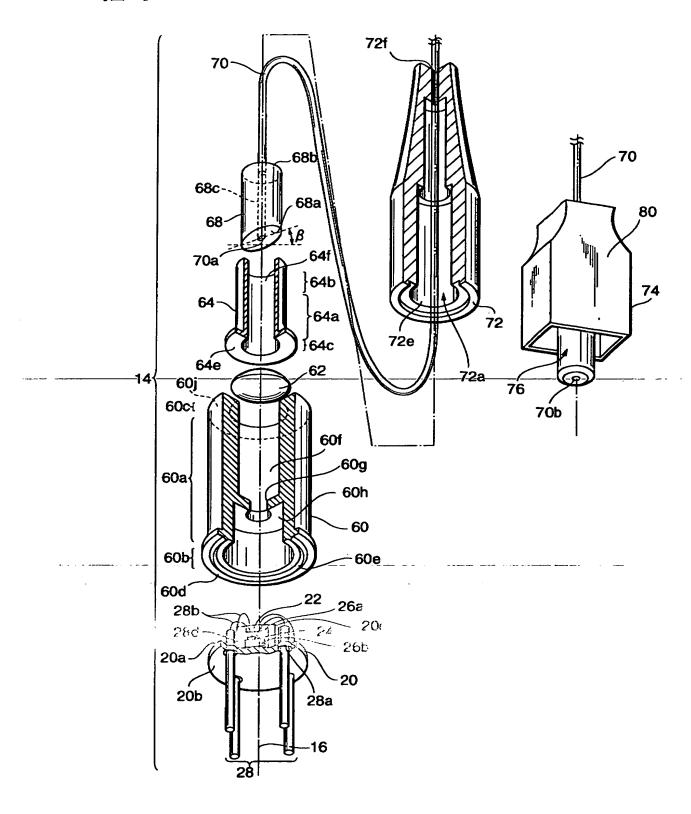




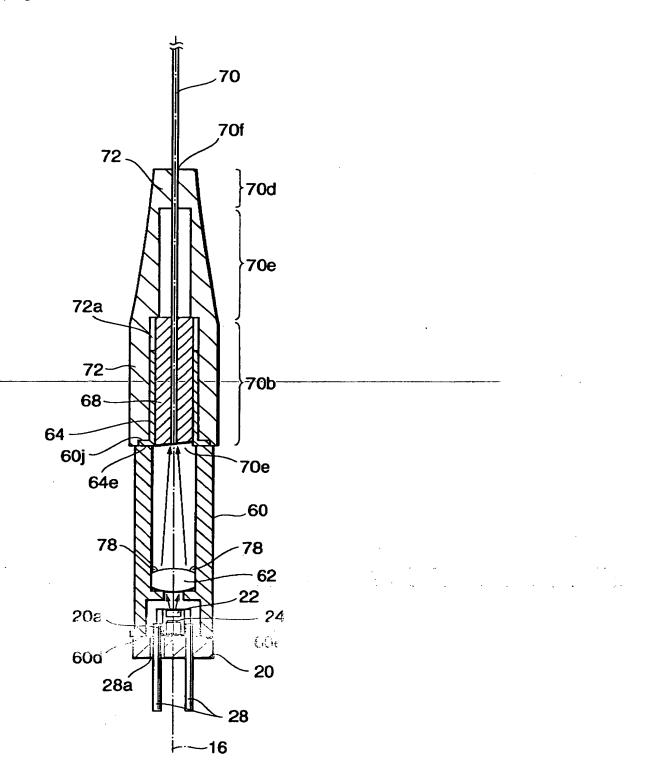
【図2】



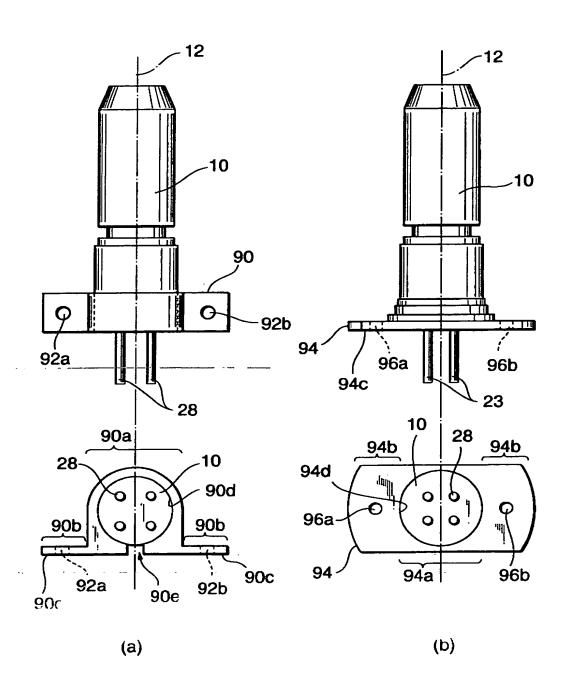




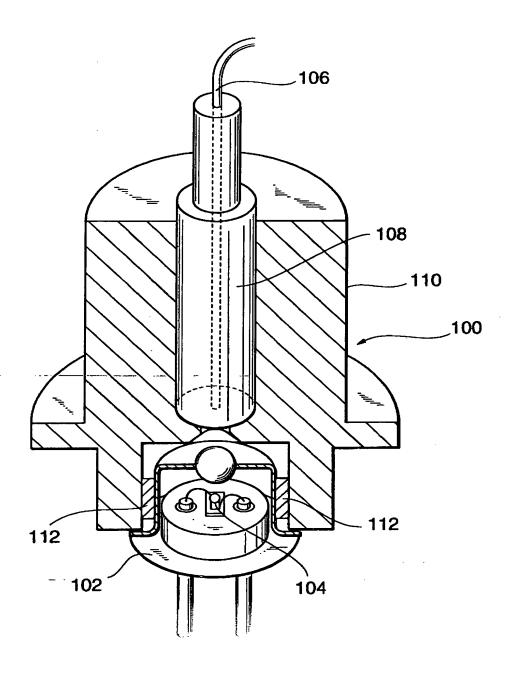








【図6】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 小型化が可能な構造を備える光半導体モジュールを提供する。

【解決手段】 光半導体モジュール10は、搭載部材20と、第1の部材30と、光半導体素子22と、第2の部材34と、光ファイバ40と、を備える。搭載部材20は、軸12に交差する基準面に沿って伸びる。第1の部材30は、軸12に沿って伸びる管状部30a、管状部30aの一端に設けられ搭載部材に固定された第1の端部30b、および管状部30aの他端に設けられた第2の端部30cを有する。光半導体素子22は、光軸が所定の軸12に沿うように第1の部材30の管状部30a内に配置されている。第2の部材34は、軸12に沿って伸びる管状部34aを有し第1の部材20の第2の端部30cに固定されている。光ファイバ40は、光半導体素子22と光学的に結合されるように第2の部材34の管状部34aにおいて伸びている。

【選択図】 図1



出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名

住友電気工業株式会社